

超音波ダイヤモンドスクライブ加工装置 US-250TVA

超音波式ヘッドは実用新案登録がされています
実用新案登録番号:3241358

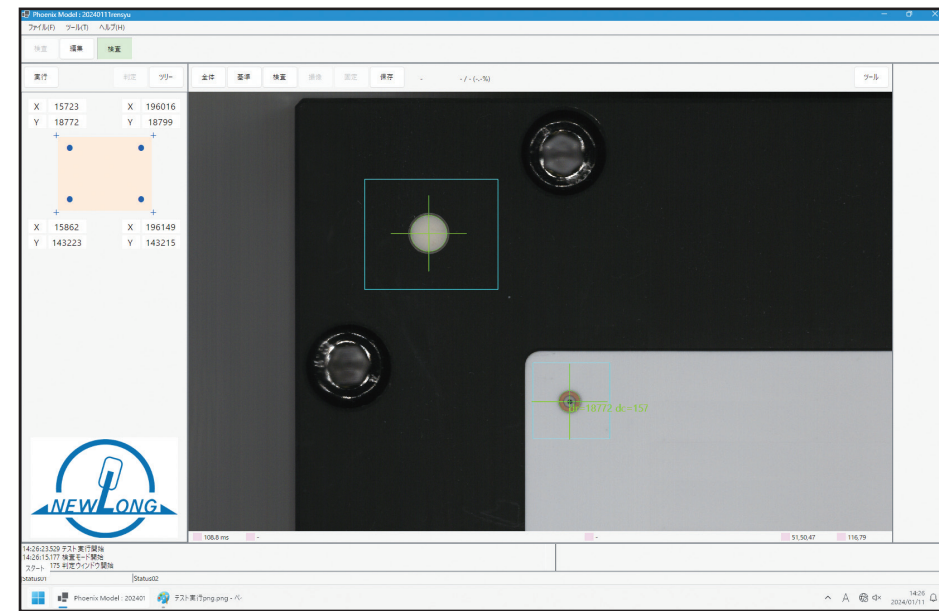
超音波式ヘッドを採用

主な特徴

- ・ソリのある基板にも対応できるスクライブヘッド
- ・超音波式ツールでダメージレス、熱影響レスの個片化
- ・スクライブ後のゴミの飛び散りが最小限
- ・高速対応により300mm/secでスクライブが可能
- ・画像処理装置により正確な位置でスクライブが可能



ヘッド部



アライメント画面

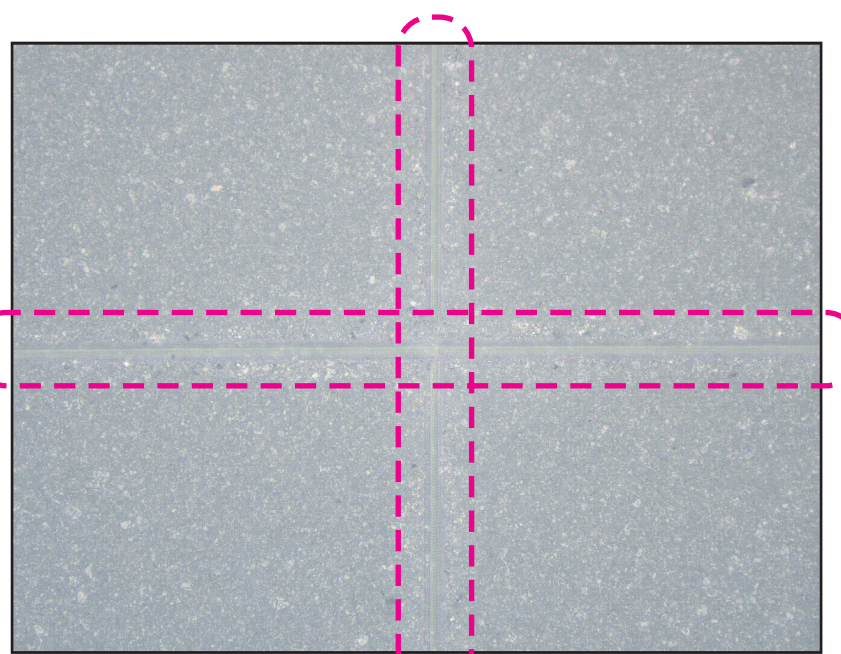
基本仕様

- ・装置寸法：1100(W)×1205(D)×1850(H) mm
(突起部、集塵機は除く)
- ・最大加工寸法：250×250mm
- ・対応厚み：0.05～2mm
- ・最適加工条件：データベース付属
- ・ワーク固定：プロア吸引による固定
- ・集塵機能：圧空ブロー+集塵機

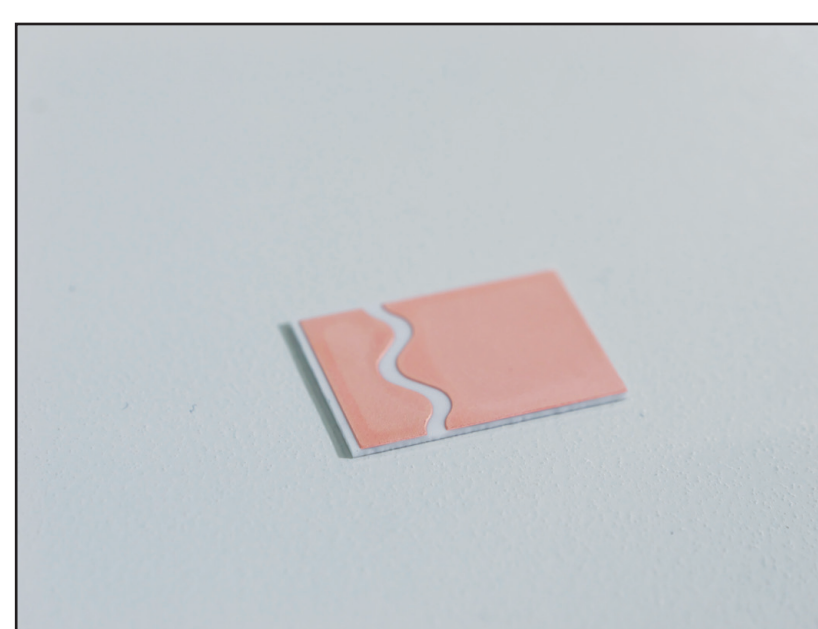


US-250TVA
スクライブ加工装置

スクライブサンプル



スクライブ後
(アルミナ基板/厚み:0.635mm)



ブレイク後